



# 中国机械工程学会摩擦学分会 Chinese Tribology Institute, CMES

## 第20届国际平坦化技术大会/CMP技术大会（ICPT 2025）

### 会议通知

第20届国际平坦化技术大会/CMP技术大会（ICPT 2025）将于2025年10月29日至11月1日在中国香港的香港科学园隆重召开。作为全球专注于平坦化技术科学交流的顶级会议，ICPT汇聚了来自全球六大半导体技术区域的CMP用户组织，致力于打造一个开放、包容、创新的国际交流平台，为业界同仁提供宝贵的合作与分享机会。本次大会将围绕多个前沿主题展开深入探讨，包括前道（FEOL）和后道（BEOL）CMP技术、耗材与设备、新兴CMP技术等。我们荣幸地邀请到多位顶尖演讲嘉宾，他们将分享精彩的学术报告与独到见解。此外，大会还将设置多场口头报告和丰富的海报展示环节，全面呈现CMP技术领域的最新研究成果与发展趋势。

我们诚挚邀请国内外高校、科研院所、企业等与平坦化技术相关的专家、学者和技术人员踊跃参会，共同分享学术经验、探讨前沿科技、激发创新思路，助力平坦化技术的研究与应用水平提升，推动相关产业蓬勃发展。在中西荟萃、动感之都的香港，我们期待与全球平坦化技术领域的学术界和产业界同仁相聚，共襄盛举！

#### ◆ 大会组织机构

指导单位：中国机械工程学会

主办单位：中国机械工程学会摩擦学分会

清华大学

协办单位：征集中...

大会主席：路新春，清华大学

组织委员会主席：屈新萍，复旦大学

顾卡丽，机械工程学会摩擦学分会

程序委员会主席：王雨春，安集科技

辅导课程委员会主席：张保国，河北工业大学



# 中国机械工程学会摩擦学分会

## Chinese Tribology Institute, CMES

### 执行委员会

中国

路新春, 清华大学  
屈新萍, 复旦大学

日本

Syuhei Kurokawa, 九州大学  
Takashi Watanabe, 铠侠公司

中国台湾

Eddy Peng, 汉民科技  
Willie Pai, 中国砂轮

### 程序委员会

中国

贾仁合, 昂士特科技  
王雨春, 安集科技  
张保国, 河北工业大学  
张力飞, 清华大学

日本

Yasuhisa Sano, 大阪大学  
Kazumi Sugai, Fujimi Inc  
Norikazu Suzuki, 中央大学  
Michio Uneda, 金泽工业大学

中国台湾

Chih Chen, 台湾阳明交通大学  
Arthur Chen, 台湾科技大学  
Ming-shih Tsai, Versum Materials  
Andy Tuan, Fil Technology

欧洲

Patrick Ong, imec  
Knut Gottfried, Fraunhofer ENAS

韩国

Jingoo Park, 汉阳大学  
Taesung Kim, 成均馆大学

美国

Gene Davis, 德州仪器  
Rob Rhoades, X-TrinSiC

欧洲

Cathérine Euvrard, CEA-Leti  
Eric Jacquinet, Merck KGaA  
Cedric Perrot, CEA-Leti  
Catharina Rudolph,  
Fraunhofer IZM-ASSID

韩国

Sanha Kim, 韩国科学技术院  
Hyunseop Lee, 东亚大学  
Kangchun Lee, 京畿大学  
Sangwoo Lim, 延世大学

美国

Mark Buehler, Intel  
Don Frye, Entegris  
Jeff McKinnis, Fujimi  
Bradley Wood, Entegris



# 中国机械工程学会摩擦学分会

## Chinese Tribology Institute, CMES

### ◆ 学术报告主题

- 前道 (FEOL) CMP 技术
- 后道 (BEOL) CMP 技术
- 缺陷、可靠性问题及 CMP 后清洗
- CMP 基础理论、建模与仿真
- 设备、工艺控制与计量学
- 新兴 CMP 技术
- CMP 耗材
- 3D ICs/TSV/封装应用
- 用于 MEMS 及混合应用的 CMP 技术
- 衬底抛光 (如 Si、SiC、GaN 和金刚石)

### ◆ 大会语言

大会官方语言为英语。

### ◆ 大会时间及地点

- 大会时间

2025年10月29日至11月1日

10月29日：注册登记、辅导课程

10月30日：注册登记

10月30日-11月1日：开幕式、学术报告、专题讨论会、专题展览、产品展示

- 大会地点

香港科学园 (沙田科技大道西12號)



# 中国机械工程学会摩擦学分会

## Chinese Tribology Institute, CMES

### ◆ 大会注册及住宿费用

| 注册类型           | 早期注册 (8月1日之前) | 标准注册 (8月2日开始) |
|----------------|---------------|---------------|
| 普通代表           | 5600元         | 6000元         |
| 委员会委员(EC, PC)) | 3700元         |               |
| 学生代表           | 1900元         | 2800元         |
| 辅导课程 - 普通代表    | 1400元         |               |
| 辅导课程 - 学生代表    | 700元          |               |

·注册费用包含：参会、会议资料、午餐、茶歇、欢迎晚会和晚宴

·差旅交通、住宿自理

会场周边推荐酒店：

香港丽豪酒店 Regal Riverside Hotel Hong Kong, Sha Tin

香港帝逸酒店 ALVA Hotel by Royal Hong Kong, Sha Tin

香港沙田万怡酒店 Courtyard by Marriott Hong Kong, Sha Tin

香港帝都酒店 Royal Park Hotel Hong Kong, Sha Tin

香港沙田凯悦酒店 Hyatt Regency Hong Kong, Sha Tin

### ◆ 联系方式：

张力飞，+86 18800111836

[lifeizhang@mail.tsinghua.edu.cn](mailto:lifeizhang@mail.tsinghua.edu.cn)

